

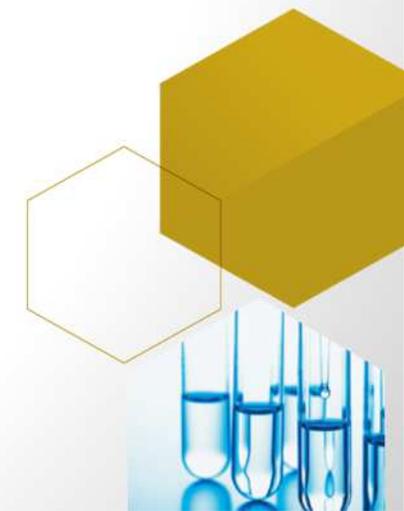
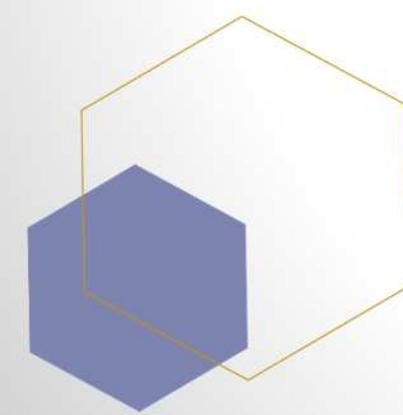
# 2023年3月期 第1四半期 決算説明資料

---

 日本高純度化学株式会社

証券コード: 4973

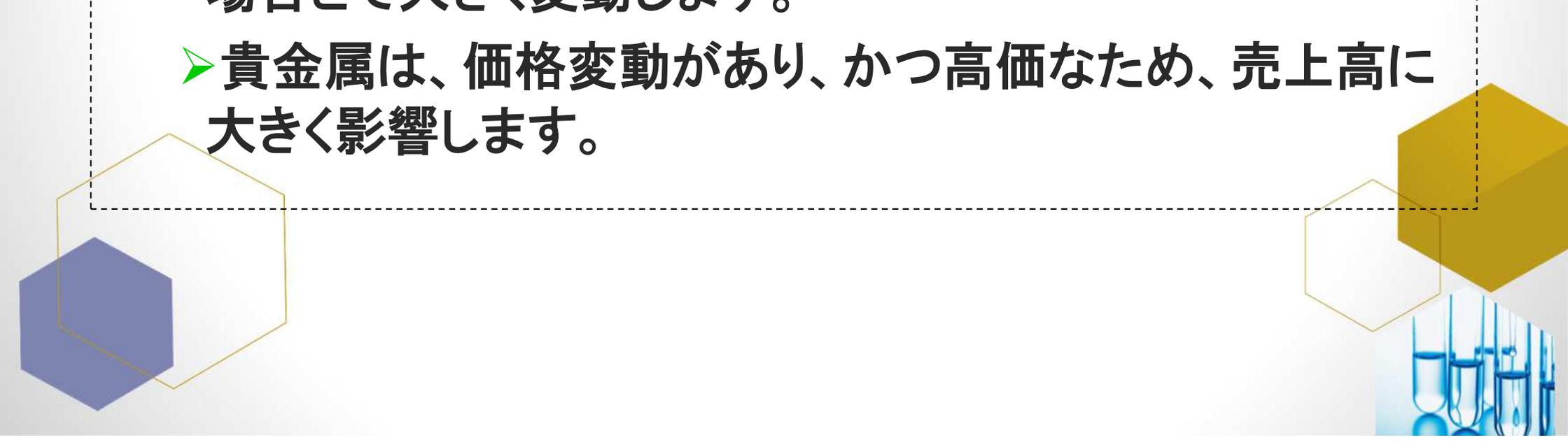
2022年7月25日





# 決算の概況

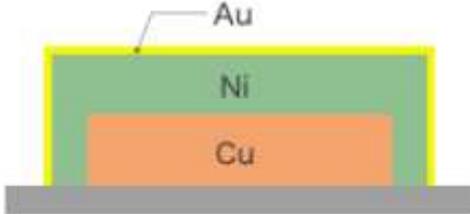
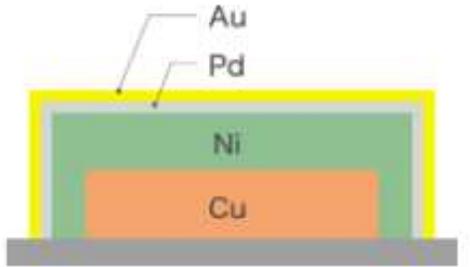
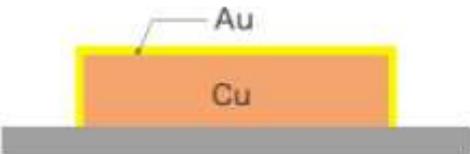
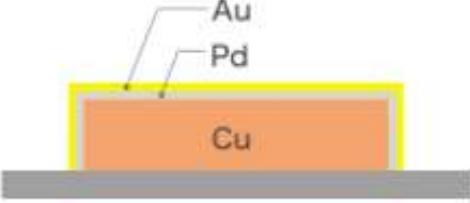
## (注)当社業績の見方のポイント

- ▶ 売上高は、薬品と一緒に貴金属を売る場合と、売らない場合とで大きく変動します。
  - ▶ 貴金属は、価格変動があり、かつ高価なため、売上高に大きく影響します。
- 

# 用語説明①(めっき方式)

用語	用途	説明
<b>電解めっき (電気めっき)</b>	—	<b>金属などの表面に電気を流してめっきする方法</b>
純金めっき	プリント基板 半導体搭載基板	高純度な純金めっき
硬質金めっき	コネクタ プリント基板	合金成分を入れて硬くした合金めっき
パラジウム (Pd)めっき	リードフレーム コネクタ	金めっきの下地めっきとして使用される PPFはPre Plated Lead frameの略
<b>無電解めっき</b>	—	<b>電気を流さず化学反応によりめっきする方法</b>
置換めっき	プリント基板	金属ごとの溶けやすさ(イオン化傾向)を利用し、下地金属の表面を置き換えて形成するめっき方法
還元めっき	プリント基板	還元剤による化学反応を利用し、厚く形成できるめっき方法

# 用語説明②(めっきプロセス)

用語	説明	めっき層構成
ENIG	銅上に無電解ニッケルめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Nickel Immersion Goldの略。層構成はCu-Ni-Au	
ENEPIG	銅上に無電解ニッケルめっき、無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Goldの略。層構成はCu-Ni-Pd-Au	
DIG	銅上に置換金めっきを直接する方法。Direct Immersion Goldの略。Niめっきを省いているためENIGに比べファインピッチ対応が可能。層構成はCu-Au	
EPIG	銅上に無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Palladium Immersion Goldの略。層構成はCu-Pd-Au	

# 製品ラインアップ ~ラインアップ拡充と新分野開拓~

めっき方式	用途	製品ラインアップ
電解	純金 	① 粗面上でも均一な膜厚が得られる純金めっき ② 硬度の高い純金めっき
	硬質金 (合金) 	マイクロコネクタ用省金硬質金めっき オーロブライト BAR7
	パラジウム(Pd) 	PPF用薄膜パラジウムめっき パラブライト NANO2
無電解	置換金 	中～高リンニッケルで使える置換金めっき IM-GOLD IB2X 下地ニッケルの腐食が少ない置換金めっき IM-GOLD CN ニッケルめっきが不要な置換金めっき IM-GOLD PC
	還元金 	亜硫酸金を使った薄膜還元金めっき HY-GOLD シアン化金を使った薄膜還元金めっき HY-GOLD CN
	還元Pd 	ENEPIG用還元パラジウムめっき ネオパラブライト 2 ダイレクト還元パラジウムめっき ネオパラブライト DP

## 新分野

卑金属(銅、スズ、ニッケル)  
合金めっき 後処理剤など

# 2023年3月期 第1四半期決算概況

## 電子部品業界の状況

- 5G対応スマートフォンと高速通信インフラ、データセンター増設、産業インフラ、工場・医療などのデジタルトランスフォーメーション向けIoTデバイスの需要に支えられ、おおむね堅調に推移した。
- PCやタブレットなど一部の電子機器向けで、巣ごもり需要の反動減や在庫調整などで軟化傾向が見られた。
- 車載用電子部品については、自動車における電装化の進展から1台あたりの電子部品や半導体搭載数の増加に伴い需要増となった。しかしながら、半導体の需給ひっ迫や中国における新型コロナウイルスの影響により部品の供給が不足し、自動車の生産面に大きな影響を与えたため、厳しい状況が続いた。

## 当社決算の概況

- プリント基板・半導体搭載基板用めっき薬品の販売が、5G対応スマートフォン、データセンター関連の需要により堅調に推移した。
- コネクタ用めっき薬品の販売については、車載向けの一部で減産の影響を受けたが、5G対応スマートフォン向けなどについては好調に推移した。
- リードフレーム用めっき薬品の販売については、中国における活動制限の影響やパラジウム価格の下落の影響を受けたが、IoTデバイスの旺盛な需要により微減に留まった。

# 2023年3月期 第1四半期決算概況

(単位:百万円、%)

	2022/3期 1Q	2023/3期		2023/3期予想	
		1Q	増減率		第1四半期 達成率
売上高	5,108	5,050	△1.1	20,000	25.3
営業利益	266	282	6.0	1,210	23.3
経常利益	326	374	14.9	1,350	27.8
四半期純利益	237	278	17.2	975	28.5
1株当たり 四半期純利益	40.88円	47.52円	—	166.54円	—

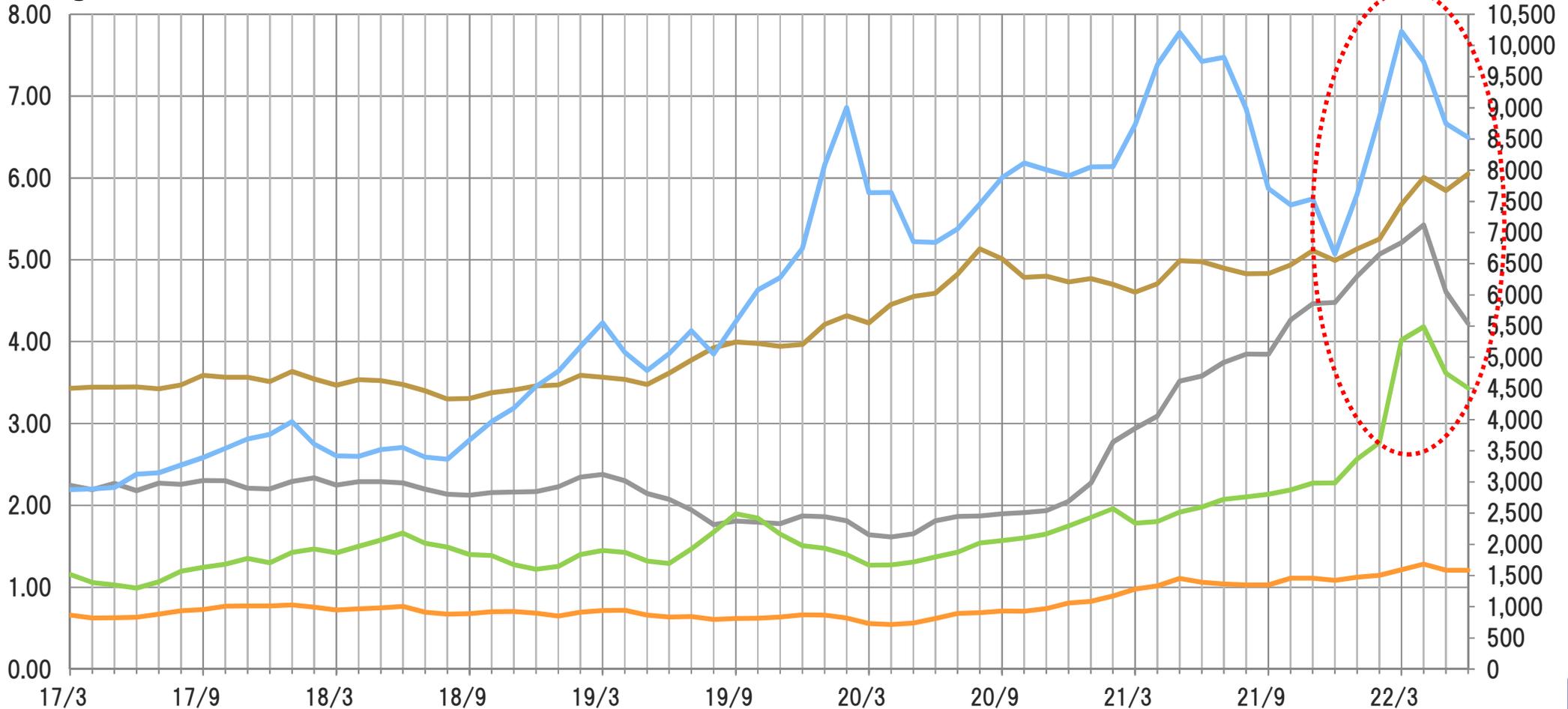
- プリント基板用及びコネクタ用めっき薬品が堅調に推移したため  
営業利益、経常利益、四半期純利益とも、前年同期比増益となった

# メタル相場推移

Prices of copper, tin and nickel  
銅、スズ、ニッケル価格

Copper 銅      Tin スズ      Nickel ニッケル

(yen/g)  
(円/g)

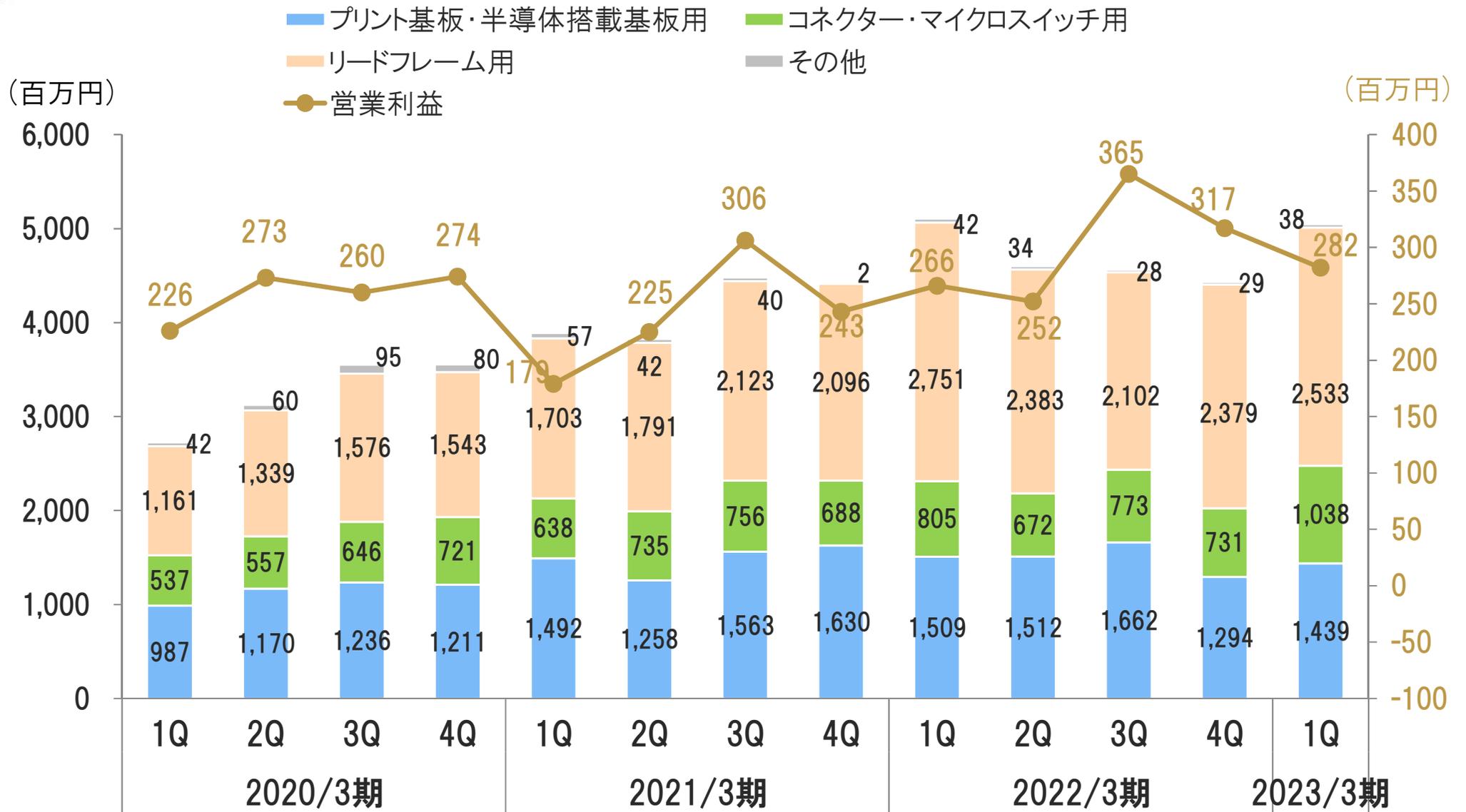


Prices of gold and palladium  
金、パラジウム価格

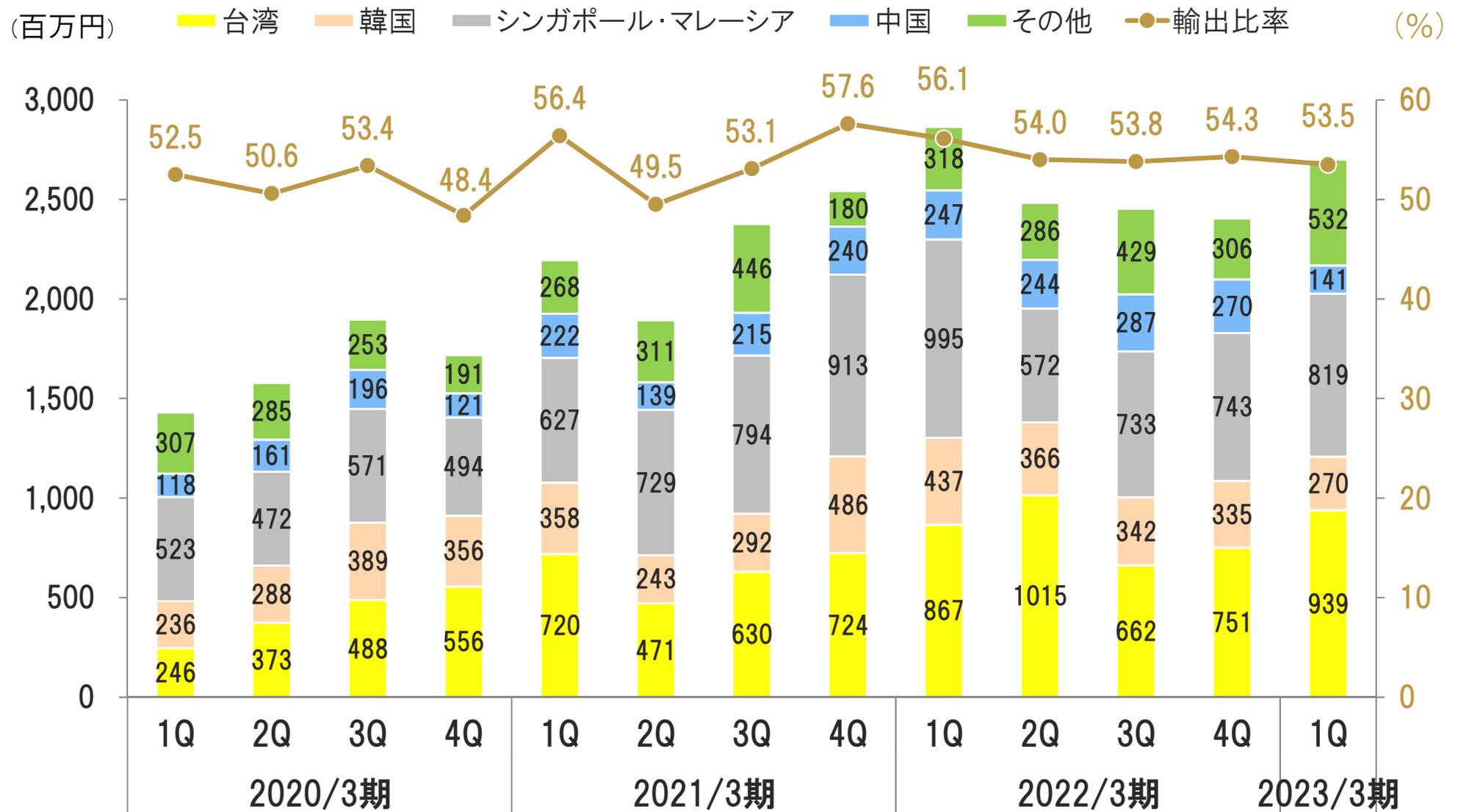
Gold 金      Palladium パラジウム

(yen/g)  
(円/g)

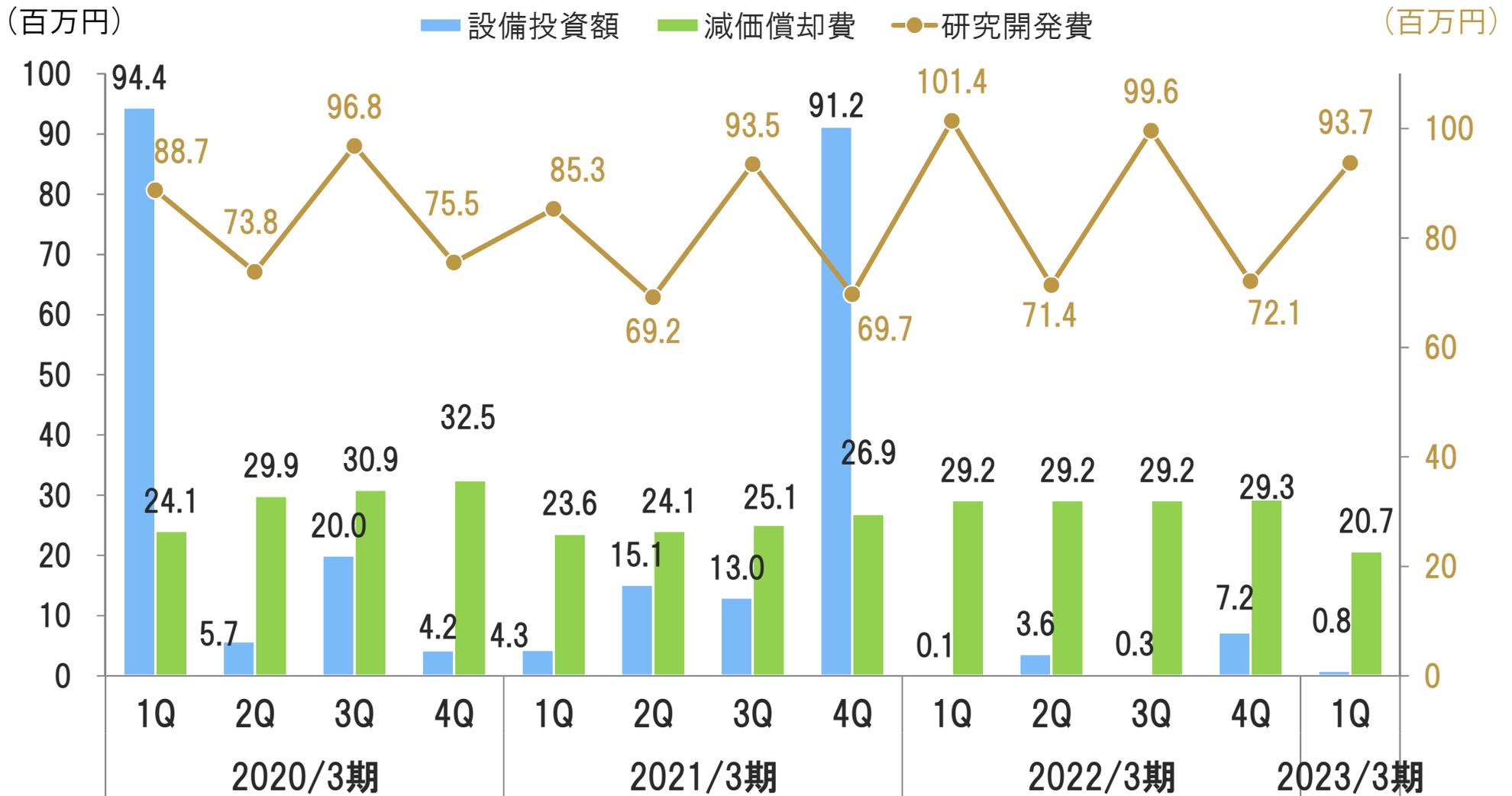
# 売上高・営業利益の推移(四半期ベース)



# 輸出地域別売上高の推移(四半期ベース)



# 設備投資額、減価償却費および研究開発費の推移



# 2023年3月期 通期の見通し

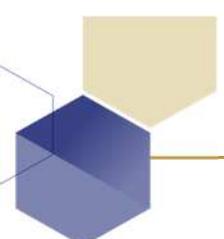
(単位:百万円、%)

	2022/3期			2023/3期		
		構成比	前期比		構成比	前期比
売上高	18,714	100.0	12.6	20,000	100.0	6.9
営業利益	1,201	6.4	25.8	1,210	6.1	0.7
経常利益	1,339	7.2	25.2	1,350	6.8	0.8
当期純利益	974	5.2	23.2	975	4.9	0.1
配当	90円	(普通配当80円) (記念配当10円)		80円		

景気不透明感に伴う需要減等のマイナス要因を、積極的な販促の展開による新製品拡大新規顧客開拓等によりカバーし、2022/3期並みの利益を確保できると予想

## ● トピックス

Ni不使用プロセスの「DIG(銅上ダイレクト金)」、「EPIG(銅上ダイレクトパラジウム/金)」は高周波特性/実装信頼性/省コストプロセスについて、完成品メーカー、基板メーカーと協力して評価を継続中



# 注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2022年6月時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

---

## お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

<https://www.netjpc.com>

# 補足資料： 会社紹介

## 沿革

- 1971年7月 会社設立
- 1999年11月 MBOを実施
- 2002年12月 JASDAQ市場に上場
- 2004年3月 東京証券取引所市場第二部に上場
- 2005年3月 東京証券取引所市場第一部に上場
- 2019年2月 一般財団法人JPC奨学財団設立
- 2020年4月 公益財団法人JPC奨学財団に認定
- 2022年4月 東京証券取引所プライム市場に移行

## 事業概要

- 電子部品業界の発展を支える電子材料を供給するファインケミカル企業
- 事業のターゲットを貴金属めっき薬品に絞り世界シェアトップクラス
- 変化の激しい業界にスピーディーに対応できる販売体制と技術サポート体制を構築
- 大規模な製造プラントを必要としないファブレス企業
- 電子部品の接続に用いる貴金属の使用量を最小限に抑える技術を提供し、資源の有効利用に貢献